

Bona R540

Karta techniczna

R540 jest 1 komponentowym poliuretanowym gruntem przeznaczonym do gruntowania chłonnych i niechłonnych podkładów przed zastosowaniem klejów do parkietów Bona; szczególnie do R770, Bona R777, Bona R820, R848T, Bona R850, R850T, Bona Titan i R870. Produkt ten może być używany również na podkładach cementowych jako bariera odcinająca wilgoć do 4% CM (wymagane dwukrotne gruntowanie).

Największe zalety

- 1-komponentowy
- Łatwo się nakłada
- Bardzo dobra przyczepność do wszystkich typów podkładów
- Głęboko penetrujący
- Nadaje się do podkładów z ogrzewaniem podłogowym

Dane techniczne

Typ produktu:	Poliizocyjanian-Prepolimer
Kolor:	Przejrzysty brązowy
Lepkość:	Rzadka ciecz
Gęstość:	1.14 g/cm ³
Temperatura obróbki:	Powietrza minimalnie 18 ^o C Podkładu minimalnie 15 ^o C Ogrzewania podłogowego maksymalnie 20 ^o C Wilgotność względna powietrza maksymalnie 70%
Wydajność:	Ok. 100 -150g / m ² jako grunt Ok. 250 - 350g / m ² jako bariera odcinająca wilgoć maksymalnie do 4% CM
Czas schnięcia:	Okolo 1 - 24 godziny w zależności od użytego kleju w 20 ^o C i 50% wilgotności względnej powietrza
Narzędzia:	Walek mohairowy, pędzel, szpachla ze stali nierdzewnej
GISCODE:	RU1
EMICODE:	-
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5 ^o C lub przekroczyć +25 ^o C podczas transportu i magazynowania. Przechowywać w suchym przewiewnym pomieszczeniu
Okres przydatności do użycia:	12 miesięcy od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu. Produkt jest wrażliwy na wilgoć. Po otwarciu pojemnika należy go szczelnie zamknąć.
Wielkość opakowań:	Kanistry 6 kg. (3 w kartonie, 132 sztuki na palecie)
Bezpieczeństwo:	Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego

Przygotowanie

Powierzchnia podkładu musi być równa, sucha, czysta i pozbawiona pęknięć, w dobrym stanie. Powinna być także lekko porowata. Jeśli to konieczne, powinna być profesjonalnie przygotowana do położenia.

Odpowiednimi podkładami (także w połączeniu w ogrzewaniem podłogowym) są:

- Cement / cementowe posadzki (CT) zgodnie z normą EN 13813
- Posadzki płynne na bazie siarczanu wapnia (anhydrytu) (CA) zgodnie z normą EN 13813 **ale tylko jako grunt. Nie jako bariera antywilgociowa.**

Skorygowano październik 2017
Ta karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje

Kleje



Bona[®]

Bona R540

Karta techniczna

Kleje



- Mastyksowe posadzki asfaltowe (AS) zgodnie z normą EN 13813
- Podkłady wyrównywane masami wyrównującymi na bazie cementu o grubości co najmniej 2 mm
- Posadzki drewniane
- Płyty wiórowe (V100)
- Stare, zniszczone podłogi po uprzednim wyczyszczeniu

Aplikacja

Przed użyciem gruntu, w pomieszczeniu muszą być spełnione następujące warunki klimatyczne (wartości dla Europy Środkowej):

- Temperatura powietrza: min. 18°C
- Temperatura podłogi: min. 15°C (z ogrzewaniem podłogowym maks. 20°C)
- Wilgotność względna: maks. 70%

Sam grunt, w razie potrzeby, musi być doprowadzony do odpowiedniej temperatury. Nakładać grunt na podkład używając wałka, pędzla lub szpachli. Uwaga: unikać powstawania kałuż. Nie stosować więcej niż zalecane zużycie. Pozostawić do wyschnięcia, do momentu, aż powstanie przezroczysta powłoka.

Opis

Zalecany czas schnięcia przed przyklejaniem parkietu wynosi:

- dla klejów R 777 i R 770 - 1 godzina;
- dla kleju Bona Titan - 6 godzin;
- dla kleju R 850 i innych silanów - 24 godziny

W przypadku używania gruntu jako bariery antywilgociowej do 4% CM należy używać gruntu dwukrotnie w odstępie czasu nie przekraczającym 24 godziny.

Prosimy o zapoznanie się także z instrukcjami dostarczonymi przez producentów parkietu.

Bona bierze odpowiedzialność tylko za dostarczony produkt, nie może brać odpowiedzialności za całą zainstalowaną podłogę. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Prosimy zapoznać się także z innymi informacjami o produktach Bona.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.